

LMPシンポジウム 2010

「レーザおよびレーザ加工の基礎と応用」

開催日時：2010年3月8日(月)

開催場所：大阪大学 接合科学研究所 荒田記念館

主 催

社団法人 日本溶接協会

レーザ加工技術研究委員会(LMP 委員会)

(Laser Material Processing Committee)

協 賛

(社)溶接学会

(社)高温学会

ステンレス協会

レーザ協会

産報出版(株)

(社)日本金属学会

(社)日本鉄鋼協会

(社)自動車技術会

レーザ加工学会

(社)レーザー学会

(社)日本チタン協会

(社)軽金属溶接構造協会

中部レーザ応用技術研究会

(順不同、依頼中含む)

〔 開催主旨 〕

近年のレーザ加工機器のめざましい発展に伴い、レーザ溶接をはじめとするレーザ加工技術の実用化が着実に進んでいます。日本溶接協会 LMP 委員会では、レーザ加工の実用化を念頭に、高出力のレーザ発振器やレーザ加工に関する最新の話題、産業応用の現状と今後の展開と課題等について、2001 年より年 1 回、レーザ加工に関する「LMP シンポジウム」を開催して参りました。

今年度は、レーザ発振器、周辺装置等が目覚しく進歩していく中で、これらを有効に使いこなすため、注目の最新のレーザ装置の特性と応用技術、新しいプロセス技術の展開とその課題、微細分野、電機・電子(太陽電池)分野および重工業(造船)分野でのトレンドをシンポジウムの主題として取り上げました。これらの最新の技術情報と技術動向に関して、開発側である大学研究機関や加工機器メーカー、さらに利用・応用側である重工業などの産業界から、それぞれ著名な専門家にご講演をお願いしております。

この貴重な機会をご利用頂き、益々発展するレーザ加工の動向をより正確に把握され、更なる新技術開発の一助として役立てて頂ければと思い、ここにご案内申し上げます。

〔 プ ロ グ ラ ム 〕

10:00～10:05	開会の挨拶	LMP 委員会 委員長 沓名 宗春 氏
セッション1 【注目のレーザー装置とその応用】		司会： 荒谷 雄 氏 (㈱レーザーックス)
10:05～10:40	半導体レーザーとその応用	大阪大学 接合科学研究所 阿部 信行 氏
10:40～11:15	ディスクレーザーとその応用	トルンプ (株) 齋藤 茂樹 氏
11:15～11:50	高出力ファイバーレーザーの現状とその適用	I P G フォトニクスジャパン (株) 辻 正和 氏
11:50～12:40	昼 食 休 憩 (昼食は各自でご用意下さい)	
セッション2 【応用技術の基礎】		司会： 山岡 弘人 氏 ((株) I H I)
12:40～13:15	レーザー加工用光学部品の進化	住友電気工業 (株) 江畑 恵司 氏
13:15～13:50	レーザー溶接時のモニタリングと適応制御	大阪大学 接合科学研究所 片山 聖二 氏
13:50～14:25	フィラーワイヤ利用ハイブリッド溶接の開発	パナソニック溶接システム (株) 西村 仁志 氏
14:25～14:40	休 憩	
セッション3 【応用技術のトピックス】		司会： 北側 彰一 氏 (日立造船 (株))
14:40～15:15	ハイブリッド溶接の造船分野への適用	三菱重工業 (株) 郷田 穂積 氏
15:15～15:50	レーザー微細加工とその変遷	(有)パラダイムレーザーリサーチ 鷲尾 邦彦 氏
15:50～16:25	シリコン太陽電池のレーザーパターニング加工	芝浦メカトロニクス (株) 岩間 誠司 氏
16:25～16:30	閉会の挨拶	LMP 委員会 幹事長 柴田 公博 氏

(希望者のみ) 16:30～17:00 接合科学研究所 レーザ接合機構学分野(片山研)関連の装置見学

【レーザー加工装置や観察装置(高速度ビデオ、X線透視観察撮影装置)等の見学】

16 kW ディスクレーザー装置	10 kW ファイバーレーザー装置
10 kW ディスクレーザー装置	3 kW 半導体レーザー装置
100 W シングルモードファイバーレーザー装置	400 W 波形制御型パルス YAG レーザ装置
マイクロフォーカス X 線透視装置	水中レーザー溶接・補修溶接用容器
高速度ビデオ・分光分析装置	センシング装置(ホットワイヤ付)等

講師及びスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。

最新情報はホームページにてご確認ください。 <http://www.jwes.or.jp/lmp/>

〔 開催要領 〕

1. 日 時

2010年3月8日(月)

2. 定 員

120名(定員になり次第、締切りとさせていただきます)

3. 参加料

会 員：10,000円(テキスト代・消費税を含む)

非会員：15,000円(テキスト代・消費税を含む)

会員とは日本溶接協会団体会員会社 <http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照です。

4. 申込要領ほか

- ・添付の参加申込書にご記入の上、FAXにて下記宛先までご送付下さい。
- ・参加料は次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は、御社にてご負担下さい)

銀行振込：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきますのでご了承下さい)

- ・振込み後の参加料は返却致しません。欠席の場合は、代理出席をお願い致します。
- ・申込受付後、FAXにて受講券をお送り致します。当日必ずご持参下さい。
- ・テキストは、当日会場受付でお渡し致します。
- ・昼食は各自でご用意願います。

5. 講習会事務局

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11 産報佐久間ビル 9階

(社)日本溶接協会 業務部 上原、内海(ウチウミ)

TEL：03-3257-1524 FAX：03-3255-5196

6. 会場

大阪大学 接合科学研究所 荒田記念館

(下記、大阪大学接合科学研究所のWebのアクセスマップ参照)

リンク <http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/access.html>

住所：〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 11番1号

交通アクセス 1. 大阪モノレール 阪大病院前駅下車 西北へ徒歩約10分

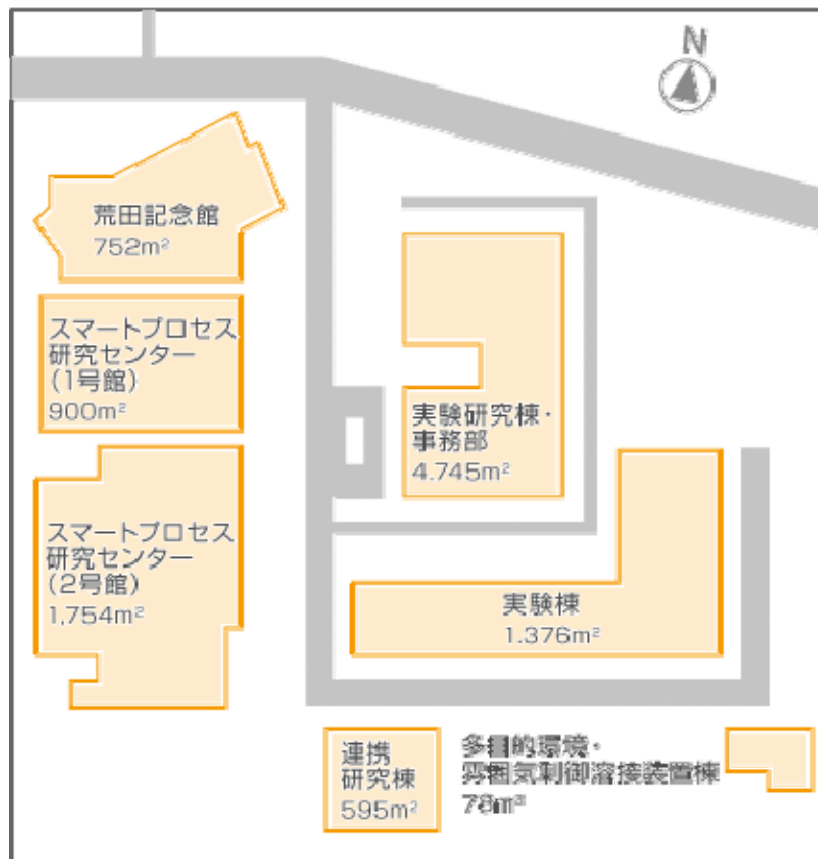
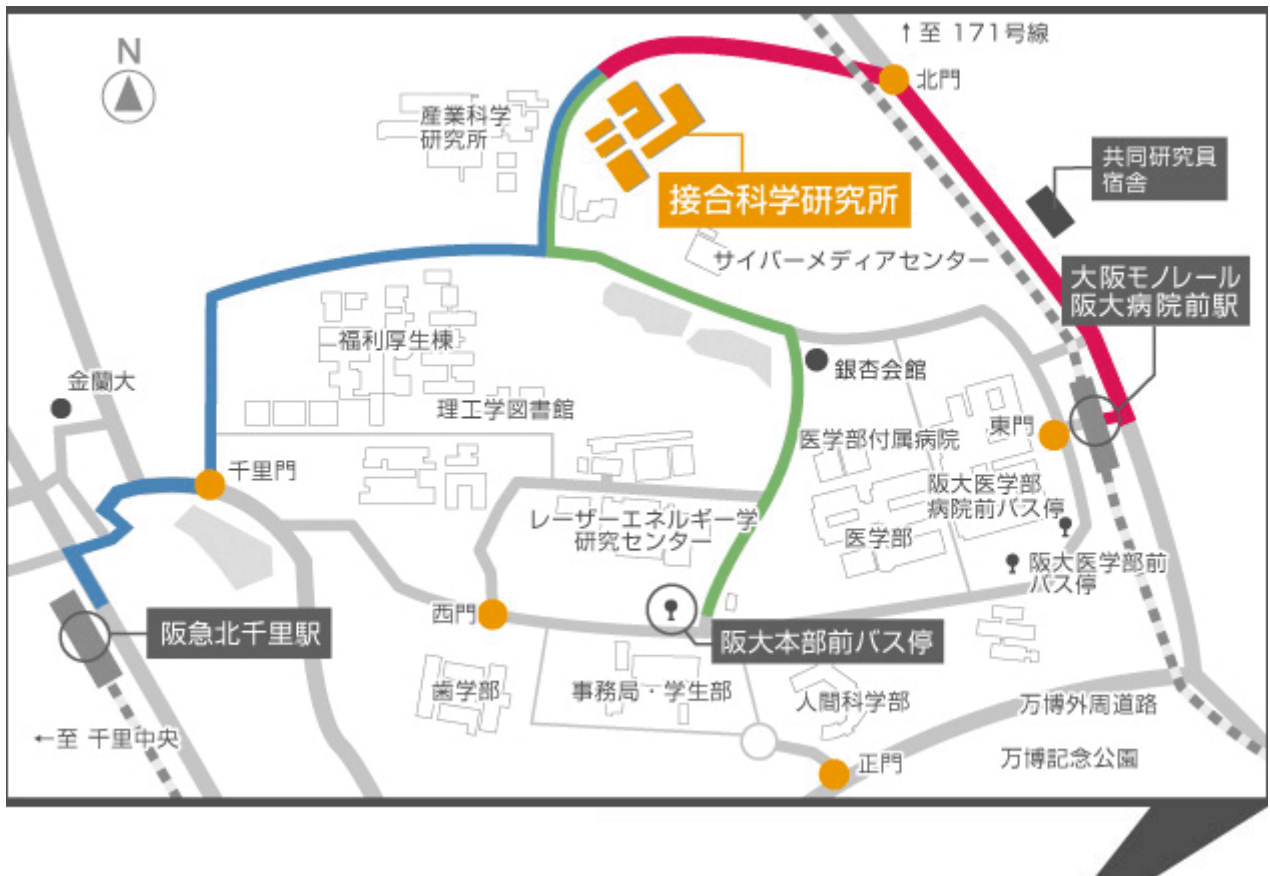
2. 阪急電鉄北千里線 北千里駅下車 東へ徒歩約30分、またはタクシーで約10分

3. 地下鉄御堂筋線 千里中央駅下車 阪急バス「阪大本部前行」または「茨木美穂ヶ丘行(阪急山田経由)」
阪大本部前下車北へ徒歩約10分

4. JR東海道線 茨木駅下車 近鉄バス「阪大本部前行(JR茨木駅経由)」 阪大本部前下車北へ徒歩約10分

5. 阪急電鉄京都線 茨木市駅下車 近鉄バス「阪大本部前行(JR茨木駅経由)」 阪大本部前下車北へ徒歩約10分

アクセスマップ



FAX : 03-3255-5196

日本溶接協会 上原、内海(うちうみ) 宛

LMPシンポジウム 2010
「レーザおよびレーザ加工の基礎と応用」参加申込書

1	フリガナ		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (会社名・部署)			
同上所在地	〒		
	TEL :	FAX :	
E-mail			
会員・非会員	会 員 ・ 非会員		
見学会(片山研)	希望する ・ 希望しない		

2	フリガナ		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (会社名・部署)			
同上所在地	〒		
	TEL :	FAX :	
E-mail			
会員・非会員	会 員 ・ 非会員		
見学会(片山研)	希望する ・ 希望しない		

記載頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、弊協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理致します。詳細については日本溶接協会 <http://www.jwes.or.jp/> をご覧下さい。

参加料：会 員：10,000円(テキスト代・消費税を含む)

非会員：15,000円(テキスト代・消費税を含む)

会員とは、日本溶接協会団体会員会社 <http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照です。

振込予定日：平成 年 月 日頃

振込金額：¥

・参加料は次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は、御社にてご負担下さい)

銀行振込： **三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会**

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきますのでご了承下さい)